

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年10月3日(03.10.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/203821 A1

(51) 国際特許分類:
G03F 7/037 (2006.01) C08K 5/1525 (2006.01)
C08G 59/22 (2006.01) C08L 79/08 (2006.01)
C08G 73/10 (2006.01) G03F 7/004 (2006.01)
C08K 5/1515 (2006.01) G03F 7/20 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/011242

(22) 国際出願日: 2024年3月22日(22.03.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-057258 2023年3月31日(31.03.2023) JP

(71) 出願人: 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 酒井 智基 (SAKAI Tomoki); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 奥田 裕美子 (OKUDA Yumiko); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 荒木 斉 (ARAKI Hitoshi); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,

HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: NEGATIVE PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION, CURED PRODUCT AND METHOD FOR PRODUCING SAME, HOLLOW STRUCTURE, ELECTRONIC COMPONENT, AND ELASTIC WAVE FILTER

(54) 発明の名称: ネガ型感光性樹脂組成物、硬化物およびその製造方法、中空構造体、電子部品、ならびに弾性波フィルター

(57) Abstract: The present invention addresses the problem of providing a negative photosensitive resin composition capable of obtaining a cured product that is excellent in low stress and low water absorption. The present invention is a negative photosensitive resin composition containing: a polyimide resin (A) that contains one or more skeletons selected from the group consisting of an alkyleneoxy skeleton, a siloxane skeleton, and an aliphatic hydrocarbon skeleton containing a linear structure; a cationic polymerizable compound (B); and a cationic polymerization initiator (C).

(57) 要約: 本発明は、低応力および低吸水性に優れた硬化物を得ることができるネガ型感光性樹脂組成物を提供することを課題としてなされたものである。本発明は、アルキレンオキシ骨格、シロキサン骨格および直鎖構造を含有する脂肪族炭化水素骨格からなる群より選択される1種類以上の骨格を含むポリイミド樹脂 (A) と、カチオン重合性化合物 (B) と、カチオン重合開始剤 (C) を含有する、ネガ型感光性樹脂組成物である。

WO 2024/203821 A1